

2026日本大阪設計創意暨發明展：引領未來設計與發明新潮流

我們誠摯邀請您參加 2026 第 13 屆日本大阪設計創意暨發明展(JDIE)，由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）主辦。本屆展覽將與 2026 世界發明簡報技巧競賽同步舉行，於 2026 年 7 月 3 日至 7 月 4 日在大阪的 KANSAI AIRPORT CONFERENCE HALLS 展覽館盛大舉行。為期兩天的精彩展程將涵蓋展覽、交流和頒獎儀式，邀請您一同見證全球創新與設計的巔峰展示。



展會亮點

全方位展覽體驗

本屆展覽突破了傳統展覽的框架，為參展者創造了一個「無界限」的展示平台。無論您的作品是設計、發明、科技、藝術還是創意表演，都可以在這裡得到充分的展示，讓您的創意充分釋放。

全球創新與交流

展會吸引了來自世界各地的設計師和發明家，是一個極佳的國際交流平台。您將有機會與來自不同國家的創新者交流觀點，擴展您的專業網絡，並參與多場專題交流會和論壇，討論最新的行業趨勢和技術。

國際級專業評審

本次展會將由各國發明領袖和專家組成的評審團，對所有參展作品進行評審。最具創意和實用性的項目將在頒獎儀式上獲得榮譽獎項，提升您的專業聲譽。這不僅是對參展者創新能力的肯定，更是推動行業發展或升學的重要契機。

展覽資訊：

- 展覽日期：2026 年 7 月 3 日~7 月 4日
- 展覽地點：KANSAI AIRPORT CONFERENCE HALLS 展覽館
- 參展費用：48,000 元/件，包含 10 位發明人報名費、展位費、桌椅、電力
海報印刷及評比費。
- 託展費用：10,000 元/件：包含現場布置、解說及作品運送。

重要時程

日期	時間	活動
7 月 3 日(五)	09：30~10：00	展位布置
	11：00~17：00	作品評比
7 月 4 日(六)	10：00~14：00	國際交流
	14：00~16：00	頒獎典禮
	16：00	大合照

報名資訊：

- 報名單位：台灣發明商品促進協會（TIPPA）
- 報名截止：2026 年 5 月 28 日
- 繳費截止：2026 年 6 月 12 日（逾期將取消參賽資格）
- 聯絡電話：02-8772-3898 賴秘書
- 電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw
- 協會網址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：

- 戶名：台灣發明商品促進協會
- 銀行：元大銀行 營業部
- 帳號：00108253826215

我們誠摯地期待您的參與，讓台灣的發明創意在全球舞台上展現光彩。這不僅是一個展示您的創新成果的機會，也是一次拓展國際視野的寶貴經歷。參加本次展會，您將有機會與全球領先的創新者建立聯繫，探索最新的技術趨勢，並在國際平台上提升您的專業形象。期待在 2026 年 7 月 3 日至 7 月 4 日與您相會，共同見證未來設計與發明的新潮流。